

## 技術詞彙表

於本文件中，除非文義另有所指，本文件中使用的與本公司及我們的業務有關的若干詞彙的解釋及定義載於下文。該等詞彙及其涵義未必總與業內標準定義或該等詞彙的用法一致。

「AAU」	指	有源天線單元，一種將天線元件與無線電單元整合為單一實體單元的物體，用於5G網路以提升效能並減少信號損耗
「ADAS」	指	先進駕駛輔助系統，任何一組輔助駕駛員駕駛和泊車的電子技術
「AI」	指	人工智能，是一門先進的技術科學，致力於研究、開發及應用模擬、增強及擴展人類智能的理論、方法、技術及系統
「AI服務器」	指	專為處理人工智能工作負載需求而構建的服務器
「ANT」	指	天線，為PCB行業普遍接受的縮寫
「AOI」	指	自動光學檢測，該系統使用數碼光學設備自動檢測電路圖案的外觀
「ASIC」	指	專用集成電路，一種為特定應用需求而定制的集成電路
「縱橫比」	指	通孔的板厚與鑽孔直徑之比，或盲孔的孔深與鑽孔直徑之比
「汽車一級供應商」	指	汽車系統集成商，為直接向汽車製造商供應組裝零部件或系統的公司。一級供應商需在汽車設計與開發階段與汽車製造商緊密合作，確保其零部件整合至最終產品中

---

## 技術詞彙表

---

「背鑽」	指	從PCB背面移除孔中多餘導電部分的工藝
「BBU」	指	基帶處理單元，是電信系統中的一種設備，通常將基帶頻率從射頻拉遠單元（可能通過光纖與之連接）傳輸
「BGA」	指	一種表面貼裝封裝，其底部引線端子形成焊球以供互連
「BMS」	指	電池管理系統，一種監控、管理及保護電池組的電子系統
「保稅區」	指	中國境內封閉式合併開放區域，其主要功能為轉口貿易、出口加工、倉儲及國際運輸。保稅區受特殊優惠政策規限。保稅區內企業在中國政府海關部門的直接監管下，將享有特殊優惠政策，並必須開展保稅區內企業與境外企業之間的貿易活動
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「覆銅板」	指	覆銅板，一種單面或雙面覆有銅箔的層壓板
「CoWoP」	指	chip-on-wafer-on-PCB，一種先進的系統級封裝(SiP)技術。其首先通過微凸點將芯片倒裝焊接至矽中介層，實現芯片與矽基板間的高密度互連。隨後將硅片上芯片(CoW)組件直接焊接至多層PCB，從而省去傳統有機封裝基板的需要
「CPU」	指	中央處理單元，即通用處理器，負責提取、解碼和執行程式指令，協調電腦系統中幾乎所有運算任務
「CTE」	指	熱膨脹系數，指在恒定大氣壓下，物體因單位溫度變化而產生的尺寸變化量

---

## 技術詞彙表

---

「數據通訊」		指涉及數據中心（包括高速網絡交換機和路由器、AI服務器、HPC及通用服務器）與無線電信網絡等設施各組件之間數據傳輸的應用
「DPPM」	指	百萬分之一的失效率，製造過程中的質量度量標準
「DPU」	指	數據處理單元，一款專為網路、儲存及安全等數據密集型任務設計的硬件加速器
「電鍍」	指	一種利用電沉積在工件表面金屬或合金的工藝，形成均勻、致密且附著良好的金屬層
「電子製造服務」	指	電子製造服務，為印刷電路板行業中電子合約製造商的公認術語
「ENIG」	指	化學鍍金
「GaN」	指	氮化鎵，一種二元III/V族直接帶隙半導體，非常適用於製造能夠在高溫下運作的高功率晶體管
「每秒千兆比特」	指	每秒千兆比特，一種常用於測量數據傳輸速度的數據傳輸速率單位
「總建築面積」	指	總建築面積
「GPU」	指	圖形處理單元，一種專為處理圖形相關任務而設計的微處理器
「HDI」	指	高密度互連的縮寫，是一種通過微過孔、細線路、薄介質層實現高元件密度和高布線密度的PCB設計與製造技術
「HPC」	指	高性能計算，一種專業化運算範式，整合先進硬件架構、平行處理技術與優化軟件生態系統，以提供極致運算效能
「HVLP3」	指	超低輪廓3型（High Very Low Profile 3），是一種先進的銅箔類型，專為最大限度降低高頻信號損耗而設計，用於製造高性能及高信賴性PCB

---

## 技術詞彙表

---

「IGBT」	指	絕緣柵雙極型晶體管，一種主要用作電子開關的三端功率半導體元件
「阻抗」	指	交流電通過由電阻、電容及電感組成的電網絡中的導體時所遇到的阻力
「L2」	指	根據國際自動機工程師學會的分類，二級駕駛自動化，即部分自動化級別。在L2下，汽車可為駕駛者控制方向盤及煞車／加速
「LED」	指	發光二極管，一種在電流通過時發光的半導體器件，用於顯示器和照明
「LiDAR」	指	激光探測及測距，一種利用激光脈沖測量距離、探測目標及為自動駕駛和繪圖等場景創建3D空間模型的遙感技術
「mil」	指	一種測量單位，等於千分之一英寸，常用於電路設計中指定厚度和間距
「MLPCB」	指	多層印刷電路板
「MOSFET」	指	金屬氧化物半導體場效應晶體管，用於放大或開關電子信號
「主板」	指	用於互連及連接電子模組陣列的印刷電路板組件
「mSAP」	指	改良半加成法，一種PCB生產方法，相較於傳統的減成法，能夠製造出更佳的線路與間距
「新能源汽車」	指	以電力或氫能等替代能源為動力的新能源汽車
「OAM」	指	基於開放加速器基礎設施(OAI)標準制定的用於算力計算的加速器模塊

---

## 技術詞彙表

---

「超大尺寸」	指	在PCB行業中，超大尺寸PCB是尺寸超過標準規格的PCB，通常指寬度超過24英吋的PCB
「PCB」	指	印刷電路板
「PCIe」	指	周邊組件互連快速通道，一種用於電子組件之間高速數據傳輸的連接類型
「電鍍」	指	一種利用化學或電化學方法將金屬沉積於金屬表面的工藝
「半固化片」	指	亦稱「PP片材」或「樹脂片材」，指由纖維增強材料浸漬熱固性樹脂並固化至半固化階段製成的片狀或卷狀材料
「PTFE」	指	聚四氟乙烯，一種合成的四氟乙烯含氟聚合物
「功率半導體 嵌入式PCB」	指	一種將功率半導體嵌入印刷線路板的技術
「粗糙度」	指	蝕刻後印刷電路板上電路導體表面及邊緣的不平整程度
「REACH」	指	歐洲議會和歐洲理事會關於化學品註冊、評估、授權和限制的法規(EC)No 1907/2006
「RF」	指	射頻
「RoHS」	指	歐盟《關於在電子電氣設備中限制使用某些有害物質的指令》
「研發」	指	研究及開發

---

## 技術詞彙表

---

「國際自動機工程師學會」	指	一個總部位於美國的全球工程專業人士學會，成員涵蓋各行業，尤其專注於運輸行業。國際自動機工程師學會根據人為介入程度及駕駛情境範圍，將駕駛自動化分為六個等級，即L0、L1、L2、L3、L4及L5，其中L5為完全自動化且無需人為介入，而L0則為並無自動化系統控制
「SiC」	指	碳化硅
「信號完整性」	指	信號在介質中傳輸的品質
「殘樁」	指	過孔中的殘留導電部分
「tce」	指	噸標準煤
「tCO <sub>2</sub> e」	指	噸二氧化碳當量
「T <sub>g</sub> 值」	指	玻璃化轉變溫度，是指PCB基板從堅硬的玻璃態轉變為柔軟、更具可塑性的狀態的臨界溫度。更高的T <sub>g</sub> 值越高表示材料在製造及操作過程中能承受更高的熱量，這對於維持PCB的結構完整性及可靠性至關重要
「UBB」	指	通用基板，指用於承載和連接服務器的各種板卡的底板
「via」	指	一個鑽穿电路板的孔，用於在不同層之間建立電氣連接的通路